

证券代码：688456

证券简称：有研粉材

有研粉末新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表（2024年8月7日）

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	西部证券
会议时间	2024年8月7日 15:00-16:00
会议地点	公司会议室
上市公司接待人员	证券事务代表：王妍 证券事务专员：瓮佳星
投资者关系活动主要内容介绍	Q1：请结合公司历史介绍公司是如何发展到现阶段的。 A1：有研粉材成立于2004年，控股股东中国有研科技集团是国务院国资委所属中央一级企业，有研粉材属于二级中央企业。公司业务分为四个板块，包括铜基金属粉体材料、微电子锡基焊粉材料、3D打印用粉体材料和电子浆料。公司铜基金属粉体材料目前在国内市场占有率约35%，产销量国内第一、全球第二，主要应用于粉末冶金、金刚石工具、摩擦材料、催化剂、电碳电刷、散热器件等下游领域，该板块的公司有有研合肥、有研重冶和境外的有研泰国、英国Makin公司；微电子锡基焊粉材料目前在国内市场占有率约15%，国内第一，该板块公司有康普锡威及其子公司；3D打印用粉体材料运营的公司为有研增材，于2021年底成立，产品除了3D打印用粉体材料还包括一些高温特种粉体材料如软磁、MIM粉等，3D打印用粉体材料应用于航空航天、JG、汽车、模具钢等领域，产品在市场上具有一定特色；电子浆料是公司目前重点发展的新板块，2023年成立有研纳微，与微电子锡基焊粉材料都属于微电子互连材料，是电子封装/组装必不可少的材料，广泛应用于电子制造业的半导

体封装、电子元器件装配、高效光伏电池等，下游主要应用于消费电子、半导体、光伏、LED 照明/显示等。

Q2: 请介绍一下公司铜粉新产品的开发情况。

A2: 铜基板目前实现突破的新产品主要为导热铜粉，主要用于制造风冷散热组件，与传统雾化铜粉相比，具有梯度孔隙结构、比表面积发达、松装密度低等特点。现已成功应用于部分散热器件，如 VC 板。该产品是公司某终端用户合作开发的产品，据了解该产品目前已经部分应用于 AI 算力服务器、基站、大型路由器、交换机等场景，应用效果截至目前反馈良好。此款铜粉在散热效率方面较传统雾化铜粉，性能提升 10%-20%，热端收益 3-5℃，属于行业内比较大的进步。目前实现每月小批量吨级销售，未来是否能进一步拓展应用领域，如传统热管等，尚有待市场进一步验证。

Q3: 散热铜粉的下游需求目前如何？

A3: 目前已经实现每月吨级供货，供应稳定。该产品在其他领域的应用也在测试阶段，目前国内只有公司能做新型散热铜粉，下游需求根据公司研发进度有望进一步扩大。

Q4: 散热铜粉具体市面上的应用有哪些？

A4: 公司新型散热铜粉现已成功应用于部分散热器件，如 VC 板，据了解该产品目前已经部分应用于 AI 算力服务器、基站、大型路由器、交换机等场景，应用效果截至目前反馈良好。

Q5: 关注到铜粉的应用领域比较分散，如何跟踪应用领域的需求变化？

A5: 公司铜基金属粉体材料应用范围很广，应用较集中的领域有粉末冶金零部件、超硬工具、摩擦材料、催化剂、电碳电刷、散热器件等，公司会根据经济形势、行业情况、销售数量、原材料价格等定期分析这些行业的需求变化情况。

Q6: 铜价上涨对公司毛利率有什么影响？

A6: 公司铜基板定价模式主要为原材料+加工费，原材料价格上涨会造成收入上升，加工费不变的情况下，会降低产品毛利率。

Q7: 锡基板未来的发展如何。

A7: 锡基焊粉材料和电子浆料都是微电子互连材料，公司锡基焊粉材料的产能能够满足目前的市场需求，板块整体的发展致力于技术迭代，并向下游新兴产业链延伸，同时调整产业结构，生产附加值更高的产品，达到 20%-30%的年增长率。

	<p>Q8: 关注到 3D 打印产品的毛利水平达 40%，下游主要是军工企业，公司对该板块未来规划如何。</p> <p>A8: 公司按照可研稳步推进。但因为 3D 打印属于新兴行业，有的产品没有行业标准，客户验证周期长，还处于逐渐增量的阶段。整体看好行业发展，公司也在不断摸索适合 3D 打印发展的最优模式。在公司的募投项目中有科技创新中心建设项目，公司通过该项目向增材制造领域加大投入规模，建设增材制造数字产业中心，探索发展 3D 打印业务。</p> <p>Q9: 公司 3D 打印粉体竞争优势是什么？</p> <p>A9: 公司不只是生产、销售 3D 打印粉体材料，更多的是依靠多年的技术和经验积累，参与客户的设计端，共同设计、开发需要的粉体材料。如生产的高流动性铝合金粉体材料，在北京“奋进新时代”主题成就展上展出，并获得航空航天增材制造产业链“创新产品奖”，可以制作卫星支架在极低温度下使用。3D 打印行业内产品种类很多，同类产品也有不同的牌号，公司定位走的是差异化细分市场，做市场上做不了的产品，解决行业卡脖子难题。</p> <p>Q10: 原材料价格上涨对公司经营的影响？</p> <p>A10: 公司的大宗有色金属会对敞口做套期保值，另外公司的定价模式会将跌价风险进行转移，短期内可能对报表数据有一些影响。</p> <p>Q11: 公司产品的其他亮点？</p> <p>A11: 公司未来研发方向是向新的应用领域拓展、延伸，也会继续延伸产业链，如铜基板块，在保持现有市占率前提下，加强新产品的研发力度，如复合铜粉、超细铜粉、低松比铜粉等高附加值产品。如电子浆料领域，专注于超细镍粉、超细铜粉、超细银粉、银包铜粉及其浆料等新产品的研发，增加互连材料的种类，可应用于 PCB、MLCC 等产品。结合国家设备更新、发展新质生产力的政策，不断调整产品结构，开发新的应用领域，形成新的产业链，扩大市场需求。</p> <p>Q12: 公司未来需要融资吗？</p> <p>A12: 公司有意愿发挥好上市平台的融资功能，借此提升主业质量，发展新质生产力，实现产业经营与资本运营融合发展、相互促进，持续推进公司高质量发展，但融资计划需要根据公司的战略规划、经营情况整体推进。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>不涉及</p>

附件清单（如有）	
日期	2024年8月12日